

◇◇◇ NPO 法人サーキットネットワーク(C-NET)定期講演会 ◇◇◇
◇◇◇ 第24回 ◇◇◇
◇◇◇ 電子立国ニッポンの復活に向けて(PartⅣ) ◇◇◇
◇◇◇ ～救世主となる半導体の動向～ ◇◇◇

主催：NPO 法人サーキットネットワーク(C-NET)

協賛：(一社)日本電子回路工業会(JPCA)

協賛：(一社)エレクトロニクス実装学会(JIEP)

皆様、今年は夏から一気に寒くなりましたが如何お過ごしでしょうか。

NPO 法人サーキットネットワーク(C-NET: 理事長梶田栄)では(一社)日本電子回路工業会(JPCA)、(一社)エレクトロニクス実装学会(JIEP)の協賛を得て、第24回定期講演会を今回もWebにて開催します。

今回は、「電子立国ニッポンの復活に向けて(PartⅣ) ～救世主となる半導体の動向～」と題して、半導体関連の各種技術を集めます。奮ってご参加願います。

* **開催日時：** 令和6年2月22日(木) 13:00～17:10

* **形態：** 開催方式：WEB開催(ZOOM使用)

- ・聴講については、原則開催日の前日までに参加URLとパスワードをご連絡します。
- ・講演の録画、録音、撮影は禁止します。
- ・同業他社の方の参加はお断りする場合がございます。ご了承ください。

* **テーマ：** 電子立国ニッポンの復活に向けて(PartⅣ) ～救世主となる半導体の動向～

* **プログラム：**

◆**基調講演**◆

13:00～14:00 「チップレット時代の世界半導体市場の今後の展開は？」
津田 建二氏 (国際ジャーナリスト)

◆**技術講演**◆

14:00～14:45 「3D パッケージング・チップレット集積化技術の最新動向」
福島 誉史氏 (東北大学)

14:45～15:30 「半導体 生かすも殺すも基板次第」
西田 秀行氏 (ニシダエレクトロニクス実装技術支援)

(休憩)

15:40～16:25 「次世代半導体パッケージ用絶縁材料の開発状況」
渡邊 真俊氏 (味の素)

16:25～17:10 「仮)先端パッケージ・サブストレートを支える有機基材の最新動向」
尾瀬 昌久氏 (レゾナック)

* **定員：** 150名(先着申込順定員になり次第締切ります)

* **講演会参加費：**(テキスト代、消費税込み)

C-NET 会員：5000円 JPCA 会員：5000円 JIEP 会員：5000円 非会員：10000円
C-NET 特別会員：無料

注) 参加費は2月19日までに請求書記載の銀行口座へお振込ください。

* **申込先：** C-NET 定期講演会、次のURLよりお申し込みください。

URL <https://jisso.jp/reg/cnet24/>

申込されますと返信メールで請求書へのリンクが発行されます。

請求書に従って、銀行振り込みにて参加費のお支払いをお願い致します。

注)メールアドレス入力ミスで、返信(受付完了)メールが不達になることが頻発しています。

メールアドレスを入力後の再確認をお願い致します。

以上